

部品内蔵基板の設計における CAD ツールの課題と対応

松岡 宏志*

Problems and Measures of CAD Tool for Designing Device Embedded Substrates

Hiroshi MATSUOKA*

* 株式会社ワイ・ディ・シー DCM 事業本部 CAD 開発部 (〒183-8540 東京都府中市府中町1-9 京王府中1丁目ビル)

* YDC Corporation DCM Business Unit CAD Development Dept. (Keio Fuchu Icchoume Bldg., 1-9 Fuchu-cho, Fuchu-shi, Tokyo 183-8540)